2017-2022年中国半导体市场运行态势及投资战略研究报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体市场运行态势及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/201701/485112.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

2016年度，半导体设备的订单需求旺盛，北美半导体设备订单出货比（BB ratio）和日本半导体设备订单出货比大部分时间大于1，同时半导体设备的订单额也处于近几年来的较高点，半导体行业正经历一波投资热潮。

2012-2016年北美半导体设备订单额和出货额（百万美元）

数据来源：公开资料

2012-2016年日本半导体设备订单额和出货额（百万日元）

数据来源：公开资料

智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体市场运行态势及投资战略研究报告》共十二章。首先介绍了半导体产业相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体行业规模及消费需求，然后对中国半导体行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2014-2016年全球半导体产业发展分析
1.1 2014-2016年世界半导体市场总体分析
1.1.1 市场特点分析
1.1.2 全球市场规模

半导体投资的主要增长因素是中国对集成电路产业的投资增长，同时NAND厂商目前在3D NAND领域的投资也有快速增长。半导体市场方面，市场销售开始复苏：2016年上半年，销售额同比为负增长；从6月份开始，降幅开始持续收窄，到9月份实现同比正增长。

2012-2016年全球半导体月销售额

数据来源：公开资料

1.1.3 市场竞争格局
1.1.4 行业整并形势

1.1.5 未来发展趋势

世界半导体贸易组织（WSTS）最新预计2016年全球半导体销售额同比将微量下跌0.1%，比春季时预测的2.4%降幅收窄，其中美洲和欧洲地区的销售额有较大的降幅，而日本和亚太地区则保持正增长。WSTS还预计2017年和2018年全球半导体销售额将实现正增长，增速分别为3.3%和2.3%，各个地区都将保持正增长。产品类别方面，传感器、模拟电路的增长率较高，尤其是传感器，在2016年预计同比增长22.6%。

世界半导体贸易组织对2016年到2018年全球半导体销售额的预测 2016 年秋季 销售额（百万美元） 同比增速（%） 2015 2016E 2017E 2018E 2015 2016E 2017E 2018E 美洲 68738 64237 67237 69001 -0.8 -6.5 4.7 2.6 欧洲 34258 32586 33352 34093 -8.5 -4.9 2.3 2.2 日本 31102 32105 32870 33446 -10.7 3.2 2.4 1.8 亚太 201070 206025 212641 217436 3.5 2.5 3.2 2.3 全球合计合计 335168 334953 346100 353977 -0.2 -0.1 3.3 2.3 分立半导体 18612 19399 19952 20603 -7.7 4.2 2.9 3.3 光电器件 33256 32059 32976 32513 11.3 -3.6 2.9 -1.4 传感器 8816 10810 11746 12341 3.7 22.6 8.7 5.1 集成电路 274484 272685 281426 288519 -1.0 -0.7 3.2 2.5 模拟电路 45,228 47,379 49,703 51,378 1.9 4.8 4.9 3.4 微处理器 61,298 62,719 63,440 64,754 -1.2 2.3 1.2 2.1 逻辑电路 90,753 88,286 90,699 92,379 -1.0 -2.7 2.7 1.9 存储器件 77,205 74,301 77,585 80,007 -2.6 -3.8 4.4 3.1 所有产品合计 335,168 334,953 346,100 353,977 -0.2 -0.1 3.3 2.3

数据来源：公开资料

1.2 2014-2016年美国半导体市场发展分析

1.2.1 美国产业形势

1.2.2 市场发展规模

1.2.3 政策助力发展

1.2.4 产业发展战略

1.2.5 未来发展前景

1.3 2014-2016年韩国半导体市场发展分析

1.3.1 全球产业地位

1.3.2 市场发展动力

1.3.3 竞争形势分析

1.3.4 产业创新模式

1.3.5 设备产业战略

1.3.6 未来市场发展

1.4 2014-2016年日本半导体市场发展分析

1.4.1 行业发展历史

1.4.2 产业发展现状

1.4.3 市场竞争格局

1.4.4 行业发展经验
1.5 2014-2016年其他国家半导体产业发展分析
1.5.1 英国
1.5.2 德国
1.5.3 印度
第二章 中国半导体产业发展环境分析
2.1 政策环境
2.1.1 智能制造政策
2.1.2 集成电路政策
2.1.3 半导体产业规划
2.1.4 “互联网+”政策
2.2 经济环境
2.2.1 国民经济运行状况
2.2.2 工业经济增长情况
2.2.3 固定资产投资情况
2.2.4 经济转型升级形势
2.2.5 宏观经济发展趋势
2.3 社会环境
2.3.1 互联网加速发展
2.3.2 智能产品的普及
2.3.3 科技人才队伍壮大
2.4 技术环境
2.4.1 技术研发进展
2.4.2 无线芯片技术
2.4.3 技术发展趋势
第三章 2014-2016年中国半导体行业发展分析
3.1 中国半导体产业发展综述
3.1.1 行业基本概述
3.1.2 行业发展意义
3.1.3 市场形势分析
3.1.4 产业发展基础
3.1.5 上游行业发展
3.2 2014-2016年中国半导体市场发展规模
3.2.1 产业发展规模
3.2.2 市场规模现状

3.2.3 销售市场规模
3.2.4 产业资金投资
3.3 2014-2016年中国半导体技术研发进展
3.3.1 技术发展现状
3.3.2 技术发展动态
3.3.3 技术未来趋势
3.4 中国半导体行业发展问题分析
3.4.1 行业发展问题
3.4.2 市场竞争困境
3.4.3 企业突围挑战
3.5 中国半导体市场发展应对策略
3.5.1 产业政策建议
3.5.2 市场应对策略
3.5.3 企业发展策略
第四章 2014-2016年中国半导体行业上游半导体材料发展分析
4.1 半导体材料相关概述
4.2 2014-2016年全球半导体材料发展状况
4.2.1 市场发展回顾
4.2.2 市场现状分析
4.2.3 行业研发动态
4.2.4 市场趋势展望
4.3 2014-2016年中国半导体材料行业运行状况
4.3.1 产业发展特点
4.3.2 行业销售规模
4.3.3 市场格局分析
4.3.4 产业转型升级
4.3.5 行业成果分析
4.4 主要半导体材料市场发展分析
4.4.1 硅片
4.4.2 靶材
4.4.3 掩膜版
4.4.4 光刻胶
4.4.5 电子气体
4.4.6 高纯化学试剂
4.4.7 化学机械研磨

4.5 半导体材料行业存在的问题及发展对策
4.5.1 行业发展滞后
4.5.2 产品同质化严重
4.5.3 供应链不完善
4.5.4 产业创新不足
4.5.5 行业发展建议
4.6 半导体材料产业未来发展前景展望
4.6.1 行业发展趋势
4.6.2 行业需求分析
4.6.3 行业前景分析
第五章 2014-2016年中国半导体行业中游集成电路发展分析
5.1 2014-2016年中国集成电路发展总况
5.1.1 全球市场规模
5.1.2 产业政策推动
5.1.3 主要应用市场
5.1.4 市场规模现状
5.2 2014-2016年中国IC设计产业发展分析
5.2.1 产业发展历程
5.2.2 市场发展现状
5.2.3 市场竞争格局
5.2.4 企业专利情况
5.2.5 国内外差距分析
5.3 2014-2016年中国晶圆制造行业发展分析
5.3.1 晶圆制造工艺
5.3.2 晶圆加工技术
5.3.3 国外企业模式
5.3.4 全球市场竞争
5.3.5 国内现行模式
5.3.6 国内市场布局
5.3.7 产业面临挑战
5.4 2014-2016年中国芯片封装测试行业发展分析
5.4.1 封装技术介绍
5.4.2 芯片测试原理
5.4.3 主要测试分类
5.4.4 封装市场现状

5.4.5 封测竞争格局
5.4.6 发展面临问题
5.4.7 技术发展趋势
5.5 中国集成电路产业发展的问题及对策
5.5.1 发展面临问题
5.5.2 发展对策分析
5.5.3 产业突破方向
5.5.4 “十三五”发展建议
5.6 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析
5.6.1 全球市场趋势
5.6.2 国内行业趋势
5.6.3 行业机遇分析
5.6.4 市场规模预测
第六章 2014-2016年中国半导体行业中游半导体设备发展分析
6.1 2014-2016年半导体设备行业发展分析
6.1.1 产业链位置
6.1.2 产业发展地位
6.1.3 市场发展主体
6.2 2014-2016年全球半导体设备市场发展形势
6.2.1 全球销售规模
6.2.2 行业投资规模
6.2.3 重点设备企业
6.2.4 发展潜力分析
6.3 2014-2016年中国半导体设备市场发展现状
6.3.1 发展形势分析
6.3.2 市场规模分析
6.3.3 销售市场格局
6.3.4 重点企业发展
6.3.5 巨大替代空间
6.4 半导体设备核心工艺发展分析
6.4.1 光刻机
6.4.2 刻蚀机
6.4.3 化学气相沉积
6.5 中国半导体设备企业面临的发展障碍
6.5.1 技术壁垒成为最大障碍

6.5.2 获得巨头认可尤为关键
6.5.3 需要大量的资金支撑
6.6 中国半导体设备市场投资机遇分析
6.6.1 行业投资机会分析
6.6.2 建厂加速拉动需求
6.6.3 国内实现进口替代
6.6.4 产业政策扶持发展
第七章 2014-2016年中国半导体行业下游应用领域发展分析
7.1 物联网
7.1.1 产业链的地位
7.1.2 市场规模现状
7.1.3 关键技术分析
7.1.4 市场并购动态
7.1.5 未来发展前景
7.2 智能手机
7.2.1 市场发展规模
7.2.2 市场竞争形势
7.2.3 半导体技术应用
7.2.4 助推半导体发展
7.2.5 发展趋势分析
7.3 医疗设备
7.3.1 市场发展规模
7.3.2 半导体器件发展
7.3.3 半导体技术应用
7.3.4 未来发展前景
7.4 车用半导体
7.4.1 市场发展形势
7.4.2 市场产值规模
7.4.3 整体竞争态势
7.4.4 车联网拉动需求
7.4.5 行业并购加速
7.5 半导体照明
7.5.1 产品发展优势
7.5.2 市场发展形势
7.5.3 全球市场现状

7.5.4 中国产业发展
7.5.5 产品价格走势
7.5.6 未来发展前景
第八章 2014-2016年中国半导体产业区域发展分析
8.1 中国半导体产业区域布局分析
8.2 2014-2016年京津渤海区域半导体产业发展分析
8.2.1 区域的发展总况
8.2.2 半导体照明产业
8.2.3 北京市场的发展
8.2.4 石家庄产业发展
8.2.5 大连的产业现状
8.3 2014-2016年长三角地区半导体产业发展分析
8.3.1 区域市场发展形势
8.3.2 江苏半导体产业发展
8.3.3 浙江半导体产业形势
8.3.4 上海打造产业集聚地
8.4 2014-2016年珠三角地区半导体产业发展分析
8.4.1 区域产业发展现状
8.4.2 区域产业链条发展
8.4.3 深圳产业发展现状
8.4.4 东莞建成产业基地
8.5 2014-2016年中西部地区半导体产业发展分析
8.5.1 区域市场发展现状
8.5.2 武汉投建产业基地
8.5.3 重庆产业发展战略
8.5.4 西安半导体产业发展
第九章 2014-2016年国外半导体产业重点企业经营分析
9.1 英特尔
9.1.1 企业发展概况
9.1.2 经营效益分析
9.1.3 半导体业务发展
9.1.4 企业业务投资
9.1.5 转型发展战略
9.2 三星
9.2.1 企业发展概况

9.2.2 经营效益分析
9.2.3 半导体业务发展
9.2.4 市场竞争实力
9.2.5 企业发展战略
9.3 高通公司
9.3.1 企业发展概况
9.3.2 经营效益分析
9.3.3 半导体业务发展
9.3.4 收购动态分析
9.3.5 未来发展战略
9.4 海力士
9.4.1 企业发展概况
9.4.2 经营效益分析
9.4.3 企业业务发展
9.4.4 厂房建设动态
9.4.5 对华战略分析
9.5 德州仪器
9.5.1 企业发展概况
9.5.2 经营效益分析
9.5.3 产销模式变革
9.5.4 企业发展动态
9.5.5 市场发展战略
9.6 东芝
9.6.1 企业发展概况
9.6.2 经营效益分析
9.6.3 企业动态分析
9.6.4 产品研发进展
9.6.5 未来发展战略
9.7 美国镁光
9.7.1 企业发展概况
9.7.2 经营效益分析
9.7.3 企业动态分析
9.7.4 企业发展战略
9.8 博通公司
9.8.1 企业发展概况

9.8.2 经营效益分析
9.8.3 企业收购动态
9.8.4 产品研发进展
9.8.5 未来发展前景
9.9 英飞凌
9.9.1 企业发展概况
9.9.2 经营效益分析
9.9.3 半导体产业发展
9.9.4 企业收购动态
9.9.5 未来发展战略
第十章 2014-2016年中国半导体产业重点企业经营分析
10.1 展讯
10.1.1 企业发展概况
10.1.2 经营效益分析
10.1.3 新品研发进展
10.1.4 产品应用情况
10.1.5 未来发展前景
10.2 台积电
10.2.1 企业发展概况
10.2.2 经营效益分析
10.2.3 产品研发进程
10.2.4 工艺技术优势
10.2.5 未来发展规划
10.3 日月光
10.3.1 企业发展概况
10.3.2 经营效益分析
10.3.3 企业合作动态
10.3.4 汽车电子封测
10.3.5 未来发展战略
10.4 联华电子
10.4.1 企业发展概况
10.4.2 经营效益分析
10.4.3 产品研发进展
10.4.4 市场布局规划
10.4.5 未来发展前景

10.5 华虹宏力
10.5.1 企业发展概况
10.5.2 经营效益分析
10.5.3 产业布局分析
10.5.4 企业发展战略
10.6 士兰微
10.6.1 企业发展概况
10.6.2 经营效益分析
10.6.3 业务经营分析
10.6.4 财务状况分析
10.6.5 未来发展前景
10.7 中芯国际
10.7.1 企业发展概况
10.7.2 经营效益分析
10.7.3 企业发展规划
10.7.4 企业收购动态
10.7.5 产能利用情况
10.7.6 未来发展前景
10.8 长电科技
10.8.1 企业发展概况
10.8.2 经营效益分析
10.8.3 业务经营分析
10.8.4 财务状况分析
10.8.5 未来发展前景
10.9 华微电子
10.9.1 企业发展概况
10.9.2 经营效益分析
10.9.3 业务经营分析
10.9.4 财务状况分析
10.9.5 未来发展前景
第十一章 中国半导体产业投资分析
11.1 产业投资现状
11.2 投资并购动态
11.2.1 索尼
11.2.2 软银

11.2.3 ARM
11.2.4 Qorvo
11.2.5 英飞凌
11.2.6 微芯科技
11.2.7 四维图新
11.2.8 福建宏芯
11.2.9 赛普拉斯
11.2.10 意法半导体
11.3 重点投资领域
11.3.1 存储
11.3.2 生产封测
11.3.3 模拟芯片
11.3.4 生产设备
11.3.5 数字芯片SOC
11.4 投资风险分析
11.4.1 宏观经济风险
11.4.2 产业政策风险
11.4.3 环保相关风险
11.4.4 技术方面风险
11.5 融资策略分析
11.5.1 项目包装融资
11.5.2 高新技术融资
11.5.3 BOT项目融资
11.5.4 IFC国际融资
11.5.5 专项资金融资
第十二章 中国半导体产业未来发展前景及趋势分析
12.1 中国半导体产业市场发展前景分析
12.1.1 市场前景分析
12.1.2 政策助力发展
12.1.3 晶圆设备需求增长
12.1.4 产业“十三五”规划
12.2 中国半导体市场未来发展趋势预测
12.2.1 产业发展趋势
12.2.2 未来发展方向
12.2.3 芯片制造基础提升

12.2.4 国产设备加速替换

图表目录：

图表 2011-2016年全球半导体市场需求各地区占比
图表 2015-2017年全球各地区半导体市场规模及增长率
图表 2015年全球8寸晶圆产能分布
图表 2015年全球12寸晶圆产能分布
图表 2016年全球十大半导体设备商市场份额
图表 2016年全球半导体下游应用结构
图表 2011-2016年日本半导体设备BB值
图表 2011-2016年北美半导体设备BB值
图表 2017-2022年全球半导体的资本支出和设备投资规模
图表 2014-2015年各地区半导体材料市场规模
图表 2013-2016年全球晶圆制造与封装材料市场规模
图表 2015年全球半导体企业销量top20
图表 2016年全球半导体企业销量top20
图表 韩国半导体产业政策
图表 美国、韩国合作研发的半导体技术
图表 韩国知识经济部支持三星电子和Hynix核心半导体设备开发
图表 日本半导体产业的两次产业转移
图表 日本半导体产业发展历程
图表 VLSI项目实施情况
图表 日本政府相关政策
图表 2016半导体芯片市场份额
图表 2015年全球十大半导体企业
图表 韩国DRAM技术完成对日美的赶超化
图表 DRAM市场份额变化
图表 日本三大半导体开发计划的关联
图表 集成电路产业链
图表 2015半导体材料生产份额
图表 半导体材料市场消费份额
图表 2016年半导体材料行业日本份额占比
图表 2016年全球半导体消费市场分布
图表 半导体产业链
图表 半导体材料分类产值
图表 半导体材料份额比例

图表 全球硅片市场份额
图表 信越化学产品分类
图表 2011-2016年日本有机硅产量
图表 信越化学竞争策略
图表 日本有机硅产量
图表 日本的“硅类高分子材料研究开发基本计划”进度表
图表 全球主要光罩生产商产品布局
图表 半导体材料份额比例
图表 全球硅片市场份额
图表 2011-2015年凸版印刷主要并购事件
图表 2013-2016年凸版印刷主要并购事件
图表 2017-2022年全球OLED面板市场预期增长情况
图表 2015年全球半导体光刻胶市场分布
图表 半导体企业经营模式发展历程
图表 IDM商业模式
图表 Fabless+Foundry模式
图表 智能制造系统架构
图表 智能制造系统层级
图表 MES制造执行与反馈流程
图表 云平台体系架构
图表 2011-2015年国内生产总值及其增长速度
图表 2015年年末人口数及其构成
图表 2011-2015年城镇新增就业人数
图表 2011-2015年全员劳动生产率
图表 2015年居民消费价格月度涨跌幅度
图表 2015年居民消费价格比2014年涨跌幅度
图表 2015年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况
图表 2011-2015年全国一般公共预算收入
图表 2011-2015年年末国家外汇储备
图表 2011-2015年粮食产量
图表 2011-2015年全部工业增加值及其增长速度
图表 2015年主要工业产品产量及其增长速度
图表 2011-2015年建筑业增加值及其增长速度
图表 2011-2015年社会消费品零售总额
图表 2011-2015年货物进出口总额

图表 2015年货物进出口总额及其增长速度
图表 2015年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表 2015年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表 2015年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度
图表 2015年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度
图表 2015年对外直接投资额（不含银行、证券、保险）及其增长速度
图表 2015年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度
图表 2015年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度
图表 2011-2015年快递业务量及增长速度
图表 2011-2015年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数
图表 2015年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度
图表 2011-2015年全社会固定资产投资
图表 2015年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比
图表 2015年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度
图表 2015年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表 2015年房地产开发和销售主要指标及其增长速度

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201701/485112.html